

主要特点

- 控制电路与RGB芯片集成在一个5050封装的元器件中，构成一个完整的外控像素点。
- 12V供电电压，有效降低整个像素点的工作电流，降低线路板压降，最大限度保证像素点在很远距离传输时达到良好的混光一致性。
- 内置信号整形电路，任何一个像素点收到信号后经过波形整形再输出，保证线路波形畸变不会累加。
- 每个像素点的三基色颜色可实现256级亮度显示，完成16777216种颜色的全真色彩显示。
- 端口扫描频率4KHz。
- 串行级联接口，能通过一根信号线完成数据的接收与解码。
- 任意两点传输距离在不超过5米时无需增加任何电路。
- 当刷新速率30帧/秒时，级联数不小于1024点。
- 数据发送速度可达800Kbps。
- 光的颜色高度一致，性价比高。

主要应用领域

- LED全彩发光字灯串，LED全彩软灯条硬灯条，LED护栏管。
- LED点光源，LED像素屏，LED异形屏。

产品概述

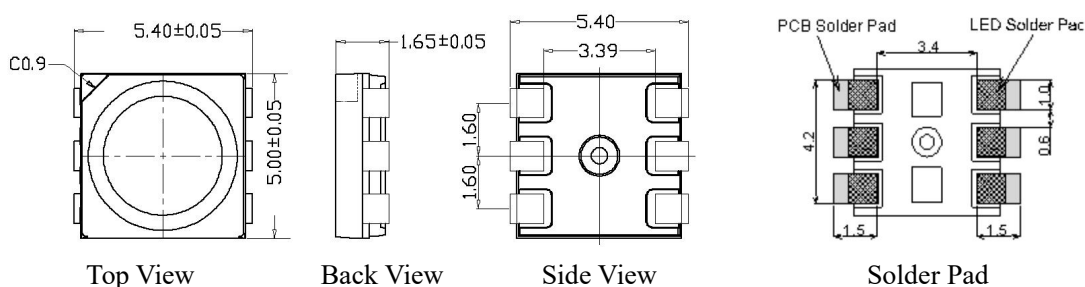
WS2815B是一个集控制电路与发光电路于一体的智能外控LED光源。其外型与一个5050LED灯珠相同，每个元件即为一个像素点。像素点内部包含了智能数字接口数据锁存信号整形放大驱动电路、高精度的内部振荡器和高精度恒流控制模块，有效保证了像素点光的颜色高度一致。实现双路信号传输，在单个像素点损坏的情况下，不影响整体色彩的显示。

数据协议采用单线归零码的通讯方式，像素点在上电复位以后，DIN1端接受从控制器传输过来的数据，首先送过来的24bit数据被第一个像素点提取后，送到像素点内部的数据锁存器，剩余的数据经过内部整形处理电路整形放大后通过DO端口开始转发输出给下一个级联的像素点，每经过一个像素点的传输，信号减少24bit。像素点采用自动整形转发技术，使得该像素点的级联个数不受信号传送的限制，仅仅受限信号传输速度要求。

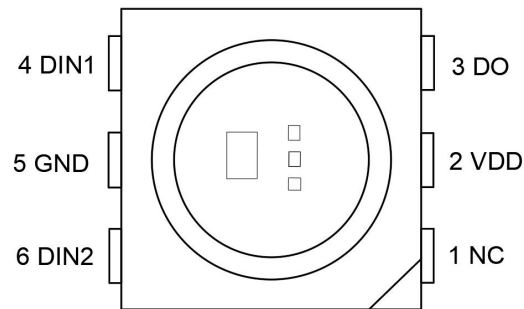
高达4KHz的端口扫描频率，在高清摄像头的捕捉下都不会出现闪烁现象，非常适合高速移动产品的使用。

280μs以上的RESET时间，出现中断也不会引起误复位，可以支持更低频率,价格便宜的MCU。

机械尺寸（单位mm）



引脚图



引脚功能

| 序号 | 符号 | 管脚名 | 功能描述 |
|----|------|----------|-------------------|
| 1 | NC | 空脚 | 空脚 |
| 2 | VDD | LED 供电电源 | 电源供电脚，接 +12V 工作电源 |
| 3 | DO | 数据输出 | 控制数据信号输出脚 |
| 4 | DIN1 | 数据 1 输入 | 控制数据信号 1 输入脚 |
| 5 | GND | 地线 | 信号接地和电源接地脚 |
| 6 | DIN2 | 数据 2 输入 | 控制数据信号 2 输入脚 |

最大额定值（如无特殊说明， $T_A=25^{\circ}\text{C}$ ， $V_{SS}=0\text{V}$ ）

| 参数 | 符号 | 范围 | 单位 |
|--------|-----------|------------|--------------------|
| 电源电压 | V_{DD} | +9.5~+13.5 | V |
| 功率 | P | 0.1~0.18 | W |
| 逻辑输入电压 | V_I | -0.3~5.7 | V |
| 工作温度 | T_{opt} | -40~+65 | $^{\circ}\text{C}$ |
| 储存温度 | T_{stg} | -40~+85 | $^{\circ}\text{C}$ |

电气参数（如无特殊说明， $T_A=25^{\circ}\text{C}$ ， $V_{DD}=12\text{V}$ ， $V_{SS}=0\text{V}$ ）

| 参数 | 符号 | 最小 | 典型 | 最大 | 单位 | 测试条件 |
|-------|----------|------|----|---------|---------------|---------------------|
| 输入电流 | I_I | — | — | ± 1 | μA | $V_I=V_{DD}/V_{SS}$ |
| 高电平输入 | V_{IH} | 2.7 | — | 5.7 | V | D_{IN}, SET |
| 低电平输入 | V_{IL} | -0.3 | — | 1.5 | V | D_{IN}, SET |

开关特性（如无特殊说明， $T_A=25^{\circ}\text{C}$ ， $V_{DD}=12\text{V}$ ， $V_{SS}=0\text{V}$ ）

| 参数 | 符号 | 最小 | 典型 | 最大 | 单位 | 测试条件 |
|--------|-----------|----|----|-----|---------------|--|
| 传输延迟时间 | t_{PLZ} | — | — | 300 | ns | $CL=15\text{pF}$, $D_{IN} \rightarrow D_{OUT}$, $R_L=10\text{K}\Omega$ |
| 下降时间 | t_{THZ} | — | — | 120 | μs | $CL=300\text{pF}$, $OUTR/OUTG/OUTB$ |
| 输入电容 | C_I | — | — | 15 | pF | — |

LED 特性参数

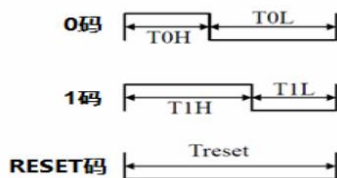
| 参数 | 符号 | 颜色 | 静态电流: <2mA | | | | 测试条件 (工作电流) |
|------|-------------|-------|------------|-----|------|-----|----------------|
| | | | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 | |
| 发光强度 | IV | Red | 200 | 310 | 400 | mcd | 12mA |
| | | Green | 600 | 800 | 1000 | | |
| | | Blue | 150 | 190 | 300 | | |
| 波长 | λ_d | Red | 620 | 623 | 630 | nm | 12mA |
| | | Green | 510 | 520 | 520 | | |
| | | Blue | 465 | 471 | 475 | | |

数据传输时间

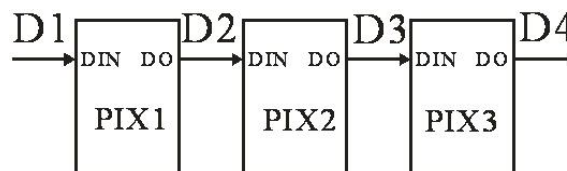
| | | |
|-------------------|------------|------------------|
| T0H | 0 码, 高电平时间 | 220ns~380ns |
| T1H | 1 码, 高电平时间 | 580ns~840ns |
| T0L | 0 码, 低电平时间 | 900ns~5000ns |
| T1L | 1 码, 低电平时间 | 600ns~5000ns |
| RES | 帧单位, 低电平时间 | 280 μ s 以上 |
| T _{DATA} | 数据周期 | $\geq 1.25\mu$ s |

时序波形图

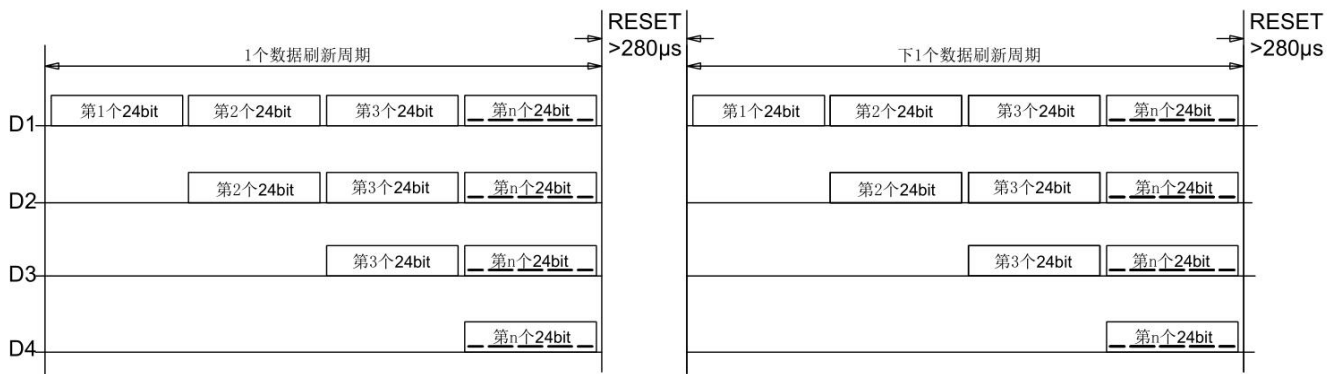
输入码型:



连接方法:



数据传输方法



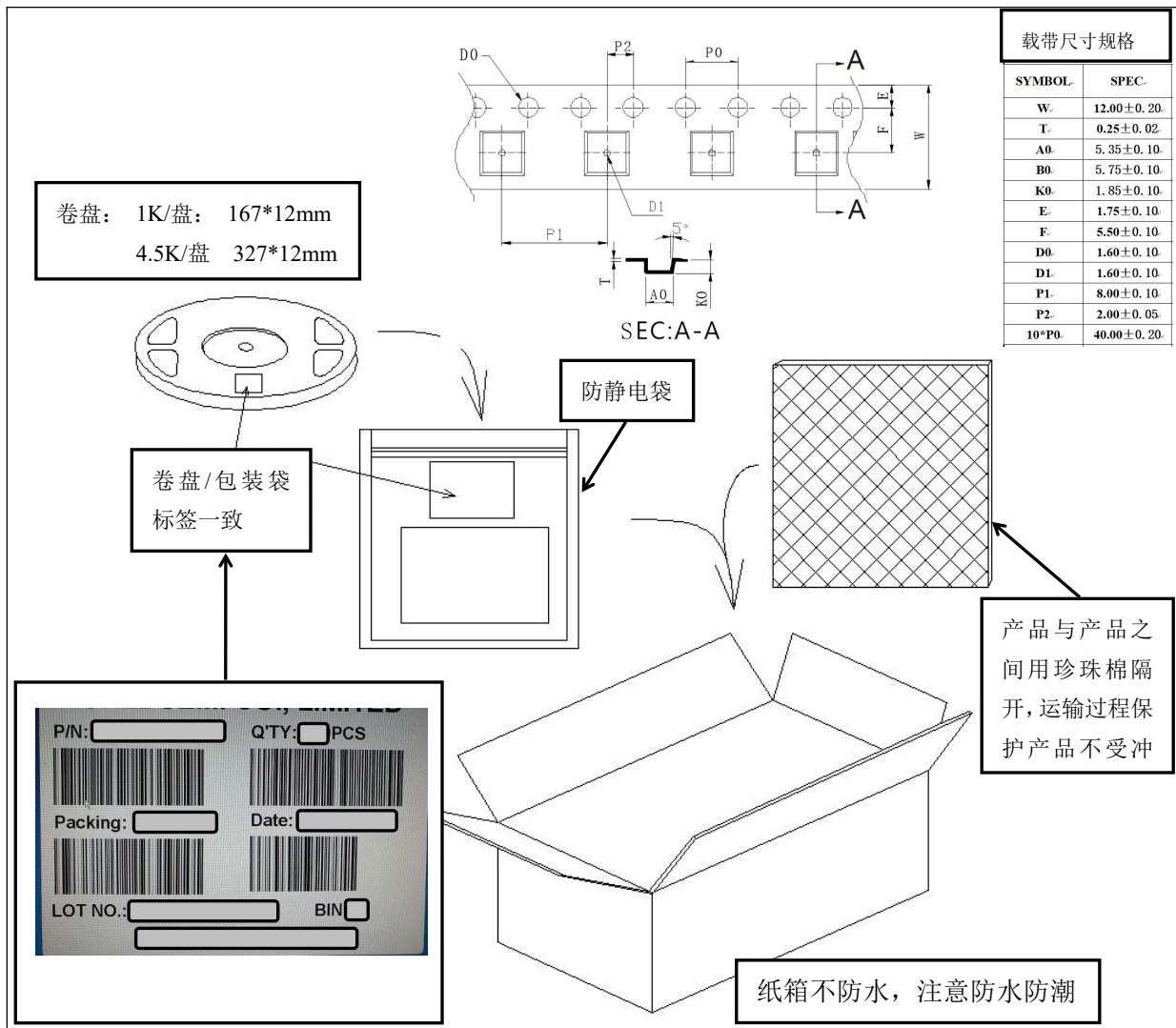
注: 其中 D1 为 MCU 端发送的数据, D2、D3、D4 为级联电路自动整形转发的数据。

24bit 数据结构

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
| G7 | G6 | G5 | G4 | G3 | G2 | G1 | R0 | R7 | R6 | R5 | R4 | R3 | R2 | R1 | R0 | B7 | B6 | B5 | B4 | B3 | B2 | B1 | B0 |
|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|

注：高位先发，按照 GRB 的顺序发送数据。

包装标准



表面贴装型 LED 使用注意事项

1. 描述:

通常 LED 也像其它的电子元件一样有着相同的使用方法, 为了让客户更好地使用华彩威的 LED 产品, 请参看下面的 LED 保护预防措施。

2. 注意事项:

2.1. 灰尘与清洁

LED 的表面是采用改性环氧胶封装的, 环氧胶对于 LED 的光学系统和抗老化性能都起到很好的保护作用。环氧胶易粘灰尘, 保持作业环境的洁净。当 LED 表面有一定限度内的尘埃, 也不会影响到发光亮度, 但我们仍应避免尘埃落到 LED 表面。打开包装袋的就优先使用, 安装过 LED 的组件应存放在干净的容器中, 在 LED 表面需要清洁时, 如果使用三氯乙烯或者丙酮等溶液会出现使 LED 表面溶解等现象, 不可使用具有溶解性的溶液清洁 LED, 可使用一此异丙基的溶液, 在使用任何清洁溶液之前都应确认是否会对 LED 有溶解作用; 请不要用超声波的方法清洁 LED, 如果产品必须使用超声波, 那么就要评估影响 LED 的一些参数, 如超声波功率, 烘烤的时间和装配的条件等, 在清洁之前必须试运行, 确认是否会影响到 LED。

2.2. 防潮处理

LED 属于湿敏元件, 将 LED 包装在铝膜的袋中是为了避免 LED 在运输和储存时吸收湿气, 在包装袋中放有干燥剂, 以吸收湿气。如果 LED 吸收了水气, 那么在 LED 过回流焊时, 水气就会蒸发而膨胀, 有可能使胶体与支架脱离以及损害 LED 的光学系统。由于这个原因, 防湿包装是为了使包装袋内避免有湿气, 但通常保护时间仅能维持 1~2 个月。此款产品防潮等级 (MSL) 为: **5a**。SMT 时请参照 IPC/JEDECJ-STD-020 规定的材料防潮等级 (MSL) 定义进行 MSL 管控。

| 防潮等级 | 包装拆封后车间寿命 | |
|----------------|--------------|--------------------|
| | 时间 | 条件 |
| LEVEL1 | 无限制 | ≤30°C/85%RH |
| LEVEL2 | 1 年 | ≤30°C/60%RH |
| LEVEL2a | 4 周 | ≤30°C/60%RH |
| LEVEL3 | 168 小时 | ≤30°C/60%RH |
| LEVEL4 | 72 小时 | ≤30°C/60%RH |
| LEVEL5 | 48 小时 | ≤30°C/60%RH |
| LEVEL5a | 24 小时 | ≤30°C/60%RH |
| LEVEL6 | 取出即用 | ≤30°C/60%RH |

2.3 SMT 贴片要求:

2.3.1 建议 LED 在 SMT 前拆袋，整卷放入烤箱中进行除湿干燥（70~75℃烘烤 \geq 24H）；

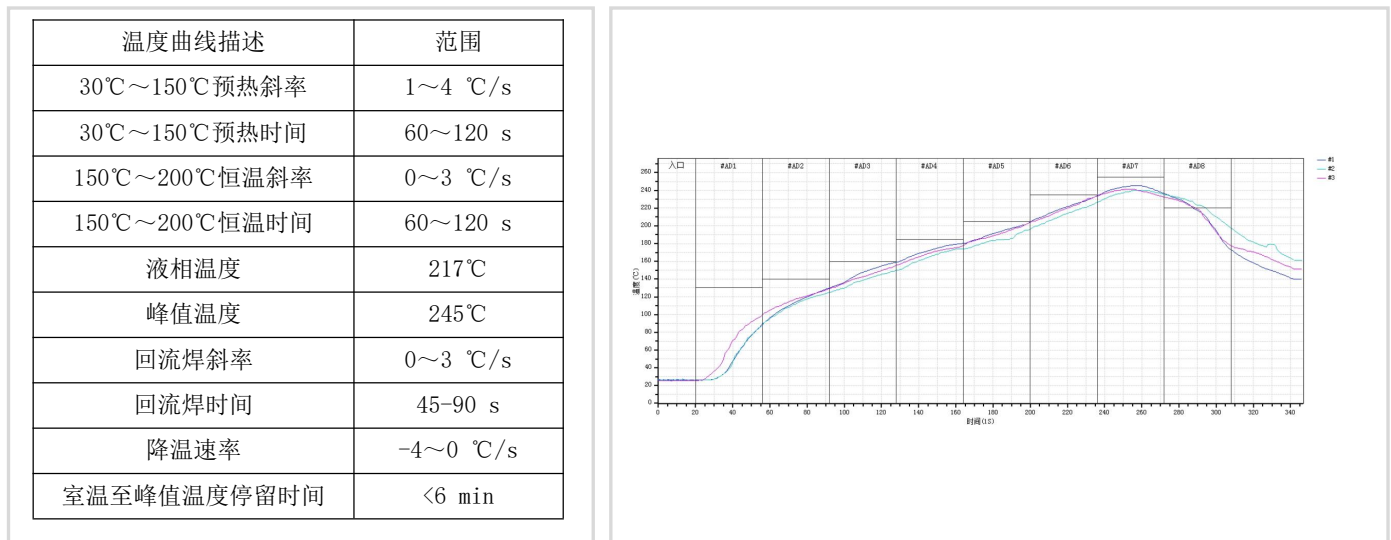
2.3.2 产品从烤箱中取出至高温焊接完成（包含多次回流焊、浸锡、波峰焊、加热维修等高温操作/作业），时间段控制在 24 内（在 T<30℃，RH<60%条件下）；

2.3.3 LED 贴片在印刷锡膏后的 PCBA 上，应尽快完成 SMT，建议不超过 1H；

2.3.4 生产剩余、机台抛料、维修用料等散料 LED，若长时间暴露在空气中，不可直接使用，建议进行除湿干燥后再被使用。整卷烘烤：70~75℃* \geq 24H 或 散料烘烤：120℃*4H。

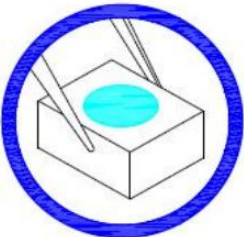

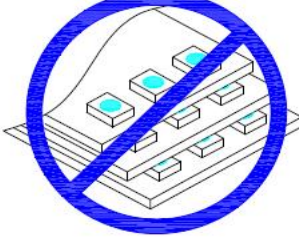

3. 焊接

表贴应用 LED 应符合 JEDECJ-STD-020C 标准，作为一般指导原则，建议遵循所用焊锡膏制造商推荐的焊接温度曲线，或使用我司如下推荐的焊接温度曲线。



注：以上所有温度是指在封装本体焊点表面测得的温度。

4. 产品配装过程注意事项

| | | | |
|---|---|--|---|
| 1. 通过使用适当的工具从材料侧面夹取 | 2. 不可直接用手或尖锐金属压胶体表面，它可能会损坏内部电路 | 3. 不可将模组材料堆积在一起，它可能会损坏内部电路 | 4. 不可用在 PH<7 的酸性场所 |
|  |  |  |  |

文件更改记录

| 版本号 | 状态 | 修改内容概要 | 修订日期 | 修订人 | 批准人 |
|------|----|------------------------|----------|-----|-----|
| V1.0 | N | 新建 | 20180820 | 沈金国 | 尹华平 |
| V1.1 | M | 修正亮度值，时序范围值，贴片注意事项部份内容 | 20190507 | 沈金国 | 尹华平 |
| V1.2 | M | 修改产品描述 | 20200519 | 沈金国 | 尹华平 |
| V1.3 | M | 修改产品描述 | 20210401 | 董乐 | 尹华平 |
| V1.4 | M | 修改使用注意事项 | 20220531 | 余行辉 | 尹华平 |
| V2.0 | M | 驱动IC升级换代，取消内置电容，参数调整 | 20221020 | 余行辉 | 尹华平 |
| V2.1 | M | 增加LED功率描述 | 20221201 | 余行辉 | 尹华平 |
| V2.2 | M | 调整时序要求 | 20221221 | 胡锦 | 余行辉 |

注：初始版本号V1.0；每次修订批准后，版本号顺序加“0.1”；

状态包括：N--新建，A--增加，M--修改，D--删除。